



●可视化检测电子模块

版本：A0

## 技术参数

参考标准 <sup>1</sup>	项目	单位	组份	
			A	B
ASTM 2196	操作性能	粘度	cps	1000±500
/		使用比例	/	1:1
ASTM 2196		混合后粘度	cps	1000±300
/		可操作时间 (25 °C)	min	60-90
/		加热固化 (80°C)	min	25±5
ASTM D2240		硬度	shore A	30±5
		耐温范围	°C	-50~200
ASTM D792		密度	g/cm <sup>3</sup>	0.95±0.1
ASTM D150		介电常数	1.2MHZ	3.0-3.3
ASTM D257		体积电阻率	Ω.cm	10 <sup>16</sup>
ASTM D149	固化后	介电强度	kV/mm	≥20
UL-94		阻燃性	UL-94	V0
ASTM D5470		导热系数	W/m.k	0.4±0.1

注1：参考标准未注日期，其最新版本适用于本文件

## 产品特点

- 良好的流动性、混合后可自动流平
- 良好的绝缘性能
- 固化后无收缩和放热现象
- 固化后柔软的弹性体
- 优良的耐热冲击性能
- 久置不板结，疏松易搅动，优异防沉防结块

## 典型应用

- 敏感元器件
- 高精度传感器
- 电子元器件和印刷线路板的灌封

## ●接线盒

## 使用说明

- 1、混合前，首先把 A 组分和 B 组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
- 2、混合时，应遵守 A 组分：B 组分 = 1: 1 的重量比。
- 3、一般而言，20mm 以下的灌封厚度产品可以自然脱泡，因为温度越高造成固化速度会加快，对灌封厚度较厚的产品，可根据需要进行脱泡。这时为了除去灌封后表面和内部产生的气泡，应把混合液放入真空容器中，在 -0.08MPa 下至少脱泡 5 分钟。
- 4、应在固化前后技术参数表中给出的温度之上，保持相应的固化时间，如果应用厚度较厚，固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响，在冬季需很长时间才能固化，建议采用加热方式固化，80°C 下固化 30 分钟，室温条件下一般需 8 小时左右固化。

## 注意事项

1. 操作完成后，A、B 未用完的胶（未混合）应立即密封保存。再次使用时需充分搅拌均匀。
2. 若不慎接触皮肤，擦拭干净，然后用清水冲洗；若不慎接触眼睛，立即用清水冲洗并到医院检查。
3. 安全性资料请参阅产品的 MSDS。

## 贮存要求

- 1、本产品为无毒非危险品，按一般化学品搬运和运输即可。
- 2、使用后注意密封，储存于阴凉、干燥、通风处。
- 3、本产品密封储存保质期为 12 个月。

## 包装规格

- 10Kg/套(A 组分 12.5Kg +B 组分 12.5Kg)  
30Kg/套(A 组分 25Kg +B 组分 25Kg)  
360Kg/套(A 组分 300Kg +B 组分 300Kg)

### 特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得，由于使用环境的差异，使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。跨越电子不担保销售产品和特定工况下使用跨越电子产品出现的问题，不承担任何直接，间接或意外损失责任。用户在使用过程遇到什么问题，可以和跨越电子技术服务部门联系，我们将为您提供一切帮助。